

御中

プロダクト／プロセス変更通知書
Product/Process Change Notification (PCN)

件名: MPC8270/8280 TBGAパッケージのモールドプロセス変更

《お願い》

本変更通知に関してご意見・ご要求のある場合は、作成日より一ヵ月以内に弊社担当営業までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

尚、ご連絡が無い場合は本変更が承認されたと判断させていただきます。



2011年12月5日

フリースケール・セミコンダクタ・ジャパン株式会社

プロダクトマーケティング本部

該当GPCN番号:

14834

変更内容:

事前にお知らせいたしましたTBGAパッケージのモールド部封止方法を弊社独自のプロセスからセンターモールドゲートと呼ばれる封止方法に変更することについて、MPC8270/8280製品について改めて正式にご連絡いたします。

変更理由:

幅広く使用されているプロセス・部材に変更することで、長期供給サポートの観点で部材調達リスクを軽減するため。

対象製品:

添付別紙をご参照ください。

変更（変更品出荷）時期:

変更開始日：2012年2月28日

出荷日を特定することはできません。

変更品の見分け方:

なし

その他:

関連通知【JPCN2011-0120 (P14740)】 [事前通知]MPC8347/9, MPC8358/60及び MPC8270/80 TBGAパッケージのモールドプロセス変更

2011-0154(14834)対象製品
MPC8270CVVQLDA
MPC8270CVVUPEA
MPC8270CZUQLDA
MPC8270CZUUPEA
MPC8270VVQLDA
MPC8270VVUPEA
MPC8270ZUQLDA
MPC8270ZUUPEA
MPC8280CVVQLDA
MPC8280CVVUPEA
MPC8280CZUQLDA
MPC8280CZUUPEA
MPC8280VVQLDA
MPC8280VVUPEA
MPC8280ZUQLDA
MPC8280ZUUPEA
SC8270ZUQLDA